

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 27 年 10 月 29 日 (2015.10.29)

【公表番号】特表 2014-532172 (P2014-532172A)
 【公表日】平成 26 年 12 月 4 日 (2014.12.4)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-066
 【出願番号】特願 2014-532060 (P2014-532060)
 【国際特許分類】

G 0 1 B 7/287 (2006.01)

G 0 6 T 1/00 (2006.01)

A 6 1 B 5/117 (2006.01)

【F I】

G 0 1 B 7/287

G 0 6 T 1/00 4 0 0 G

A 6 1 B 5/10 3 2 2

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成 27 年 9 月 2 日 (2015.9.2)
 【誤訳訂正 1】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 1 0
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 1 0】

この目的及び他の目的、特徴、利点は、本発明に従って、筐体及び筐体によって支持された回路を含み得る電子デバイスによって提供される。また、電子デバイスは、例えば、筐体によって支持され、回路に結合された指感知デバイスを含んでもよい。指感知デバイスは、実装基板、及び実装基板に隣接した下面を有する半導体インタポーザを含んでもよい。指センサは、また、半導体インタポーザの上面において並列かつ接触関係にあり、少なくとも 1 本の指を感受する指感知面を規定する、複数の半導体指感知ダイを含んでもよい。したがって、指感知デバイスは、例えば他の大面積指感知デバイスと比べて構造剛性が高く、指紋画像データの損失量が少ない。

【誤訳訂正 2】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 1 5
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 1 5】

方法の態様は、指感知デバイスの作製方法に関する。本方法は、例えば実装基板に隣接した下面を有する半導体インタポーザを位置決めする工程を含んでもよい。本方法は、半導体インタポーザの上面において複数の半導体指感知ダイを並列かつ接触関係になるように位置決めし、少なくとも 1 本の指を感受する指感知面を画定する工程と、を更に含んでもよい。

【誤訳訂正 3】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 1 6
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 1 6】

【図 1】本発明に係る指感知デバイスを含む電子デバイスの概略平面図である。

【図 2】図 1 の指感知デバイスの上面図である。

【図 3】図 2 の指感知デバイスの断面図である。

【図 4】図 2 の複数指感知デバイスの縁が接した指感知ダイの、接した縁の拡大平面図である。

【図 5】本発明の別の実施形態に係る別の複数指感知デバイスの上面図である。

【図 6】本発明の別の実施形態に係る指感知デバイスの断面図である。

【図 7】本発明の別の実施形態に係る指感知デバイスの断面図である。

【図 8】本発明の別の実施形態に係る指感知デバイスの断面図である。

【誤訳訂正 4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 2 5

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 2 5】

半導体指感知ダイ 2 3 が、並列かつ接触関係で配列され、より詳細には、列と行で配列される。半導体指感知ダイ 2 3 の並列かつ接触関係は、例えば、複数の指 6 1 を感受するのに面積で十分な指感知面を画定する。

【誤訳訂正 5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 4 2

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 4 2】

別の態様は、実装基板 2 1 に隣接した下面を有する半導体インタポーザ 2 2 を位置決めする工程を含む、指感知装置 2 0 の作成方法を対象とする。この方法は、また、少なくとも 1 本の指に対する指感知面を画定するために、半導体インタポーザ 2 2 の上面において半導体指感知ダイ 2 3 を並列かつ接触関係になるように位置決めする工程を含む。